

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

灿芯半导体（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华夏基金、中欧基金、广发基金、交银基金、诺安基金、安联基金、安信基金、博道基金、淳厚基金、东方证券、东吴证券、富国基金、工银安盛资产、光大证券、国金证券、国泰产险、国泰海通证券、国泰基金、国投证券、国信证券、红土创新基金、华安证券、华宝基金、华泰资产、金鹰基金、农银汇理基金、鹏华基金、平安养老、平安资管、浦银安盛基金、融通基金、勤辰基金、上海证券、申万菱信基金、太平基金、太平资产、天弘基金、万家基金、西部利得基金、鑫元基金、兴全基金、兴业基金、银河基金、域秀资本、长江证券、长信基金、招银理财、浙商基金、浙商资管、中海基金、中金资管、中信保诚基金、中信建投证券、中信证券资管、中银资管、毕盛投资、宏道投资、景行泰来产业基金、昱奕资产、天演论资本、南土资产、中泰证券
时间	2025 年 12 月 5 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理庄志青先生 董事会秘书沈文萍女士 证券事务代表石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	公司情况简要介绍： 灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。 依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质

	<p>量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、汽车电子、智慧城市等行业。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2025 中国 IC 设计成就奖之年度优秀 IC 设计服务公司”等多项荣誉奖项。</p> <p>2025 年前三季度，公司实现营业收入 4.68 亿元，同比下降 45.74%，其中，芯片设计业务实现营业收入 2.39 亿元，同比增长 24.24%，芯片量产业务实现营业收入 2.29 亿元，同比下降 65.83%，</p> <p>芯片量产业务收入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致。2025 年第三季度，公司实现营业收入 1.86 亿元，较第二季度环比增长 30.28%。其中，芯片设计业务实现营业收入 0.97 亿元，环比增长 49.44%，芯片量产业务实现营业收入 0.89 亿元，环比增长 14.23%。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在手订单金额为 8.72 亿元（含税，下同），其中芯片设计业务在手订单 2.89 亿元，芯片量产业务在手订单 5.82 亿元。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、公司 2025 年 1-9 月的营业收入变动原因？</p> <p>答：2025 年前三季度，公司实现营业收入 4.68 亿元，同比下降 45.74%，其中，芯片设计业务实现营业收入 2.39 亿元，同比增长 24.24%，芯片量产业务实现营业收入 2.29 亿元，同比下降 65.83%，主要系去年同期对公司量产业务贡献较大的部分客户因其需求变动减少对公司采购，同时公司新增项目收入尚不足以弥补前述收入变动影响所致。与此同时，公司 2025 年第三季度芯片设计及量产业务收入环比均有所增长，呈现改善态势。</p> <p>2、公司目前在人工智能等新兴领域的布局情况？</p> <p>答：公司自主开发了一系列可复用、可配置的 SoC 行业应用解决方案与一系列高性能 IP，覆盖物联网、人工智能、消费电子、工业控制、汽车电子、数据中心、高速存储等众多领域，可满足不同客户的多样化需求。未来，公司将继续利用自身丰富的设计服务经验与现有系统级芯片设计平台方案优势，针对客户产品具体场景应用需求进行 IP 及系统方案定制，快速满足客户差异化需求。</p>
--	---

在人工智能、数据中心及智能汽车等领域的强劲需求驱动下，高速接口 IP 技术正加速迭代，成为芯片设计的核心支撑之一。公司基于 28HKC+ 工艺平台的 DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB 等高速接口 IP 已完成验证并实现量产交付，能够为数据中心 AI 加速芯片、车载 SoC 等高性能场景需求提供支持，同时上述 IP 集成先进信号完整性（SI）和电源完整性（PI）设计，能够提升 IP 在复杂电磁环境下的可靠性。在 28HKD 工艺平台上，全线 DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB 等高速接口 IP 完成客户小批量验证，新增的 PSRAM 和 EMMC IP 产品线进一步补充了公司在低功耗存储接口领域的布局。公司基于 22nm 工艺平台的 DDR5 IP 完成架构验证，DDR5 IP 核技术是支撑新一代高性能计算芯片的关键模块，主要涵盖控制器、PHY 物理层及完整子系统解决方案，通过高速率、低功耗及创新架构设计，已深度融入 AI 计算、数据中心、移动终端及工业控制等高性能领域。

3、公司对未来发展的展望？

答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括：

（1）技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。

（2）市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电子、端侧 AI、AI+IoT 等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。

（3）研发团队建设与管理效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培养计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本

	<p>（4）并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 12 月 5 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无